

# Dell EMC PowerEdge C6520

## Especificaciones técnicas

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

# Tabla de contenido

<b>Capítulo 1: Especificaciones técnicas</b> .....	<b>4</b>
Dimensiones del sled.....	4
Peso del chasis.....	5
Especificaciones del procesador.....	5
Especificaciones de PSU.....	5
Sistemas operativos compatibles.....	5
Especificaciones de la batería del sistema.....	6
Especificaciones del soporte vertical para tarjetas de expansión.....	6
Especificaciones de la memoria.....	6
Drives.....	7
Especificaciones de almacenamiento.....	7
Especificaciones de puertos y conectores.....	8
Especificaciones de puerto USB.....	8
Especificaciones del puerto de pantalla.....	8
Especificaciones del puerto NIC.....	8
Especificaciones del puerto de iDRAC9.....	8
Especificaciones de vídeo.....	8
Especificaciones ambientales.....	9
Especificaciones de contaminación gaseosa y de partículas.....	10
Restricciones térmicas.....	10

# Especificaciones técnicas

En esta se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema.

## Temas:

- Dimensiones del sled
- Peso del chasis
- Especificaciones del procesador
- Especificaciones de PSU
- Sistemas operativos compatibles
- Especificaciones de la batería del sistema
- Especificaciones del soporte vertical para tarjetas de expansión
- Especificaciones de la memoria
- Drives
- Especificaciones de almacenamiento
- Especificaciones de puertos y conectores
- Especificaciones de vídeo
- Especificaciones ambientales

## Dimensiones del sled

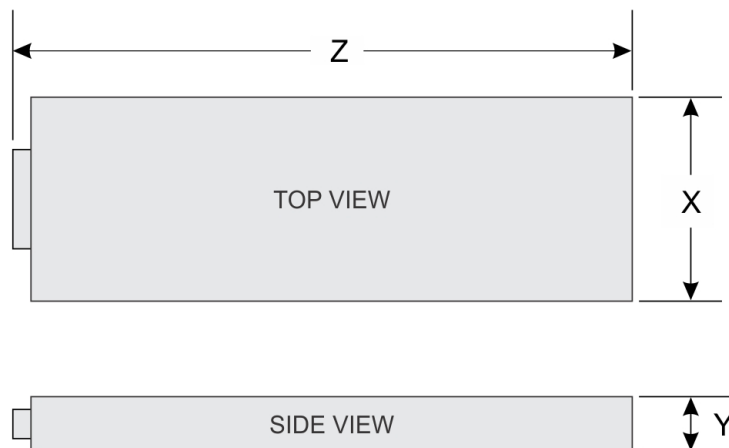


Ilustración 1. Dimensiones del sled

Tabla 1. Dimensiones del trineo PowerEdge C6520

X	Y	Z
447,04 mm (17,6 pulgadas)	86,36 mm (3,4 pulgadas)	802,64 mm (31,6 pulgadas)

## Peso del chasis

Tabla 2. Peso del chasis del gabinete con los trineos PowerEdge C6520

Configuración del sistema	Peso máximo (con todos los sleds y unidades)
12 x 3.5 pulgadas	45,6 kg (100,53 lb)
24 x 2,5 pulgadas	41,4 kg (91,27 lb)
Sistema sin backplane	35 kg (77,16 lb)

## Especificaciones del procesador

Tabla 3. Especificaciones del procesador PowerEdge C6520

Procesadores admitidos	Número de procesadores admitidos
3 <sup>a</sup> generación Procesadores escalables Intel Xeon con hasta 40 núcleos	Dos

## Especificaciones de PSU

El sistema PowerEdge C6520 es compatible con hasta dos unidades de suministro de energía (PSU) de CA.

Tabla 4. Especificaciones de PSU

PSU	Clase	Disipación de calor (máxima)	Frecuencia	Voltaje	CA		Corriente
					Línea alta	Línea baja de 100 a 120 V	
2600 W	Platinum Platinum	9750 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V autoajustable	2600 W(220 -240 V)	1400 W	16 A
2400 W	Platinum	9000 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V autoajustable	2400 W(200 -240 V)	1400 W	16 A
2000 W	Platinum	7500 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V autoajustable	2000 W(200 -240 V)	1000 W	11,5 A
1600 W	Platinum	6000 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V autoajustable	1600 W (200-240 V)	800 W	10 A

**NOTA:** La PSU de 2600 W con el número de referencia 9D4R6 solo es compatible con el cable adaptador C14-C19.

**NOTA:** Este sistema también ha sido diseñado para la conexión a sistemas de alimentación de TI con un voltaje entre fases no superior a 240 V.

**NOTA:** La disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios del sistema de alimentación.

**NOTA:** Cuando seleccione o actualice la configuración del sistema, para garantizar un consumo de energía óptimo, verifique el consumo de energía del sistema con Dell Energy Smart Solution Advisor, disponible en [Dell.com/ESSA](http://Dell.com/ESSA).

## Sistemas operativos compatibles

El sistema PowerEdge C6520 soporta los siguientes sistemas operativos:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Hipervisor Citrix
- Microsoft Windows Server con Hyper-V

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- Controladores del entorno de preinstalación de Windows (WinPE) de 64 bits

Para obtener más información, visite [www.dell.com/ossupport](http://www.dell.com/ossupport).

## Especificaciones de la batería del sistema

El sistema PowerEdge C6520 admite batería de sistema Pila tipo botón de litio CR 2032 de 3 V.

## Especificaciones del soporte vertical para tarjetas de expansión

El sistema PowerEdge C6520 es compatible con cuatro tarjetas de expansión PCI express (PCIe) de 4.ª generación como máximo.

**Tabla 5. Ranuras de tarjetas de expansión compatibles con la tarjeta madre del sistema**

Ranura PCIe	Tarjetas verticales	Ancho del soporte vertical	Altura de la ranura de PCIe	Longitud de la ranura de PCIe	Ancho de la ranura PCIe
Ranura 1	Soporte vertical 1a	PCIe x16	Perfil bajo	Media longitud	x8
Ranura 1	Soporte vertical 1b con soporte para el módulo SNAP I/O	PCIe x16	Perfil bajo	Media longitud	x8 + x8
Ranura 2	Soporte vertical 2b	PCIe x16	Perfil bajo	Media longitud	x8

**NOTA:** Para obtener información sobre las pautas de instalación de la tarjeta de expansión, consulte el sistema específico *Manual de instalación y servicio* disponible en <https://www.dell.com/poweredgemanuals>

## Especificaciones de la memoria

El sistema PowerEdge C6520 es compatible con las siguientes especificaciones de memoria para un funcionamiento optimizado.

**Tabla 6. Especificaciones de la memoria**

Tipo de módulo DIMM	Rango de DIMM	Capacidad de DIMM	Un procesador		Procesadores dobles	
			Capacidad mínima del sistema	Capacidad máxima del sistema	Capacidad mínima del sistema	Capacidad máxima del sistema
RDIMM	Banco único	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	Banco dual	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
		32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
		64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
LRDIMM	Banco cuádruple	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
		128 GB	128 GB	1 TB	256 GB	2 TB

**Tabla 7. Sockets de módulo de memoria**

Sockets de módulo de memoria	Velocidad
16, 288-pin	3200 MT/s, 2933 MT/s, 2666 MT/s

# Drives

El sistema PowerEdge C6520 admite:

- 12 x 3,5 pulgadas unidades SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pulgadas
- 24 x 2,5 pulgadas unidades NVMe/SAS/SATA (HDD/SSD) de 2,5 pulgadas

**Tabla 8. Cantidad máxima de opciones de unidad compatibles con el trineo PowerEdge C6520**

Número máximo de unidades en el sled	Número máximo de unidades asignadas por sled
12 x 3,5 pulgadas sistemas de unidades de 3,5 pulgadas	Tres unidades SAS o SATA y SSD SATA por trineo
24 x 2,5 pulgadas configuraciones de unidades que no son NVMe de 2,5 pulgadas	Seis unidades SAS o SATA y SSD SATA por trineo
8 configuraciones de unidades NVMe de 2,5 pulgadas (2 unidades NVMe por trineo/8 unidades NVMe por chasis)	El plano posterior NVMe es compatible con cualquiera de estas configuraciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos unidades NVMe y cuatro unidades SAS o SATA y SSD SATA por trineo</li> <li>• Seis unidades SAS o SATA y SSD SATA por trineo</li> </ul> <b>NOTA:</b> Las unidades NVMe están limitadas a la velocidad de la PCIe de 3.ª generación.
24 x 2,5 pulgadas configuraciones de unidades NVMe de 2,5 pulgadas	Seis unidades NVMe por trineo
Unidad SATA M.2 (opcional)	La capacidad compatible de la tarjeta SATA M.2 es de 960 GB como máximo <b>NOTA:</b> La tarjeta SATA M.2 se puede instalar en el soporte vertical M.2 o en la tarjeta BOSS
Tarjeta microSD (opcional) para el arranque (hasta 64 GB)	Una en el Soporte vertical 1a

**NOTA:** Para obtener información sobre cómo intercambiar el dispositivo SSD U.2 PCIe NVMe en caliente, consulte la *Guía del usuario de la SSD PCIe NVMe Express Flash de Dell* en <https://www.dell.com/support> **Examinar todos los productos > Infraestructura de centro de datos > Controladoras y adaptadores de almacenamiento > SSD PCIe NVMe Express Flash de Dell PowerEdge > Documentación > Manuales y documentos.**

## Especificaciones de almacenamiento

El trineo PowerEdge C6520 admite:

**Tabla 9. Tarjetas controladoras de almacenamiento para el sistema**

Controladoras internas	Controladoras externas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC H745</li> <li>• HBA355i</li> <li>• HBA345</li> <li>• S150</li> <li>• H345</li> <li>• Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x SSD M.2</li> <li>• H350</li> <li>• H750</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS Ext. de 12 Gbps HBA</li> </ul>

**Tabla 10. Opciones de RAID compatibles con unidades SATA M.2**

Opciones	Unidad SATA M.2 única sin RAID	Unidades SATA M.2 dobles con RAID de hardware
RAID de hardware	No	Sí

**Tabla 10. Opciones de RAID compatibles con unidades SATA M.2 (continuación)**

Opciones	Unidad SATA M.2 única sin RAID	Unidades SATA M.2 dobles con RAID de hardware
Modo RAID	N/A	RAID 1, RAID 0
Número de unidades compatibles	1	2
CPU compatibles	CPU 1	CPU 1

**NOTA:** Las opciones de RAID solo son compatibles en las tarjetas BOSS que compatibles, a su vez, con dos unidades SATA M.2.

## Especificaciones de puertos y conectores

### Especificaciones de puerto USB

El trineo PowerEdge C6520 es compatible con el USB 3.0 en la parte posterior del sistema.

### Especificaciones del puerto de pantalla

El trineo PowerEdge C6520 es compatible con 1 Mini DisplayPort .

### Especificaciones del puerto NIC

El trineo PowerEdge C6520 es compatible con uno de los puertos de controladora de interfaz de red (NIC) de 10/100/1000 Mbps integrados en la LAN en placa base (LOM) e integrados en las tarjetas de OCP opcionales.

**Tabla 11. Especificación del puerto de la NIC para el trineo**

Función	Especificaciones
Tarjeta de LOM	1 GbE
Tarjeta OCP 3.0	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4

### Especificaciones del puerto de iDRAC9

El trineo PowerEdge C6520 es compatible con 1 puerto para iDRAC Direct (USB microAB) ubicado en la parte posterior del sistema.

## Especificaciones de vídeo

El sistema PowerEdge C6520 es compatible con la controladora de gráficos Matrox G200 incorporada con 16 MB de buffer de trama de vídeo.

**Tabla 12. Opciones de resolución de vídeo frontales admitidas para el sistema**

Solución	Tasa de actualización (Hz)	Profundidad del color (bits)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32

**Tabla 12. Opciones de resolución de vídeo frontales admitidas para el sistema (continuación)**

Solución	Tasa de actualización (Hz)	Profundidad del color (bits)
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

## Especificaciones ambientales

**NOTA:** Para obtener más información sobre las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos medioambiental de productos ubicada con los documentos en [www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home).

**Tabla 13. Categoría de rango climática y operacional A3**

Temperatura	Especificaciones
Operaciones continuas permitidas	
Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m (<= 2953 pies)	De 5 a 40 °C (41 a 104 °F) sin luz directa del sol en el equipo
Rangos de porcentaje de humedad (sin condensación en todo momento)	8 % de RH con un punto de condensación mínimo de -12 °C a 85% de RH con un punto de condensación máximo de 24°C (75,2°F)
Reducción de valores nominales de altitud en funcionamiento	La temperatura máxima se reduce 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pies) por encima de los 900 m (2953 pies)

**Tabla 14. Requisitos compartidos en todas las categorías**

Temperatura	Especificaciones
Operaciones continuas permitidas	
Gradiente de temperatura máxima (se aplica en funcionamiento y cuando no está en funcionamiento)	20 °C en una hora* (36 °F en una hora) y 5 °C en 15 minutos (41 °F en 15 minutos), 5 °C en una hora* (41 °F en una hora) para cinta <b>NOTA:</b> * Según las reglas térmicas de ASHRAE para el hardware de cinta, estas no son tasas instantáneas de cambio de temperatura.
Límites de temperatura cuando el sistema no está en funcionamiento	-40 a 65 °C (-104 a 149 °F)
Límites de humedad cuando el sistema no está en funcionamiento	De 5 % a 95 % de RH con un punto de condensación máximo de 27 °C (80,6 °F)
Altitud máxima en estado no operativo	12 000 metros (39 370 pies)
Altitud máxima en funcionamiento	3048 metros (10 000 pies)

## Especificaciones de vibración máxima

**Tabla 15. Especificaciones de vibración máxima**

Vibración máxima	Especificaciones
En funcionamiento	0,26 Grms de 5 Hz a 350 Hz (todas las orientaciones de funcionamiento)
Almacenamiento	1,88 Grms de 10 Hz a 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis lados).

## Especificaciones de impulso de impacto máximo

Tabla 16. Especificaciones de impacto máximo

Impacto máximo	Especificaciones
En funcionamiento	Seis impulsos de descarga 6 G ejecutados consecutivamente en los ejes positivo y negativo x, y y z durante un máximo de 11 ms (cuatro impulsos en cada lado del sistema).
Almacenamiento	Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes "x", "y" y "z", positivo y negativo (un impulso en cada lado del sistema), de 71 G durante un máximo de 2 ms.

## Especificaciones de contaminación gaseosa y de partículas

En la siguiente tabla, se definen las limitaciones que ayudan a evitar daños en el equipo de TI y/o fallas causadas por contaminación gaseosa o con partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o con partículas están por encima de los límites especificados y causan daños o fallas en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La corrección de las condiciones medioambientales será responsabilidad del cliente.

Tabla 17. Especificaciones de contaminación de partículas

Contaminación de partículas	Especificaciones
Filtración de aire	<p>ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con un límite de confianza superior del 95%.</p> <p><b>i</b> <b>NOTA:</b> Esta condición solo se aplica a los ambientes de centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no se aplican a los equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales como una oficina o una fábrica.</p> <p><b>i</b> <b>NOTA:</b> El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtración MERV11 o MERV13.</p>
Polvo conductor	<p>El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras partículas conductoras.</p> <p><b>i</b> <b>NOTA:</b> Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.</p>
Polvo corrosivo	<ul style="list-style-type: none"><li>El aire debe estar libre de polvo corrosivo.</li><li>El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.</li></ul> <p><b>i</b> <b>NOTA:</b> Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.</p>

Tabla 18. Especificaciones de contaminación gaseosa

Contaminación gaseosa	Especificaciones
Tasa de corrosión de planchuela de cobre	<300 Å/ mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013
Tasa de corrosión de planchuela de plata	<200 Å/mes, según lo definido por ANSI/ISA71.04-2013.

**i** **NOTA:** Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa

## Restricciones térmicas

**i** **NOTA:**

1. No está disponible: indica que Dell EMC no ofrece la configuración.

2. No admitido: indica que la configuración no se admite a nivel térmico.

**NOTA:** Todos los componentes, incluidos los módulos DIMM, las tarjetas de comunicaciones, la SATA M.2 y las tarjetas PERC, pueden ser compatibles con suficiente margen térmico si la temperatura ambiente es igual o inferior a la temperatura máxima de funcionamiento continuo que aparece en estas tablas.

**NOTA:** Algunas configuraciones de hardware del sistema requieren un límite de temperatura superior más bajo. Para obtener más información sobre el requisito de temperatura de funcionamiento, comuníquese con el soporte técnico.

**NOTA:** Algunas configuraciones requieren una temperatura ambiente menor. Para obtener más información, consulte las siguientes tablas.

En las siguientes tablas, se enumeran restricciones clave para la temperatura ambiente, en función de la CPU configurada en el sistema. Todas las temperaturas de entrada que se proporcionan a continuación se encuentran en centígrados de grados continuos.

**Tabla 19. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador doble con configuración de unidad NVMe de 2,5 pulgadas/directa de 2,5 pulgadas: enfriado por aire**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
8380	270	40	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8368	270	38	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8368Q	270	38	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8362	265	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8360Y	250	36	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8358	250	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8358P	240	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	20
6348	235	28	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	20
6342	230	24	No compatible	No compatible	No compatible	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	No compatible	20	20	20	25
6346	205	16	No compatible	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352 M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*

**Tabla 19. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador doble con configuración de unidad NVMe de 2,5 pulgadas/directa de 2,5 pulgadas: enfriado por aire (continuación)**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

**NOTA:**

- Los datos con el \* significan que pueden tener una compensación de temperatura de + 5 °C, si utiliza el procesador extendido 1 con HSK en esta configuración.
- H745 no es compatible con el procesador TDP > 185 W.
- Se requieren restricciones térmicas adicionales para la configuración de GPU y LRDIMM de 128 GB, y PCIE > 25 W.

**Tabla 20. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador 1 único con configuración de unidad directa de 2,5 pulgadas: enfriado por aire**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25
8368Q	270	38	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8362	265	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352 M	185	32	35	35	35	35	35

**Tabla 20. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador 1 único con configuración de unidad directa de 2,5 pulgadas: enfriado por aire (continuación)**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

**NOTA:** Se requieren restricciones térmicas adicionales para la configuración de GPU y LRDIMM de 128 GB, y PCIE > 25 W.

**Tabla 21. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 2,5 pulgadas: enfriado con aire**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
8380	270	40	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8368	270	38	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8368Q	270	38	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8362	265	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8360Y	250	36	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8358	250	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
8358P	240	32	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
6348	235	28	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
6342	230	24	No compatible	No compatible	No compatible	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25

**Tabla 21. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 2,5 pulgadas: enfriado con aire (continuación)**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	No compatible	No compatible	20	20
6346	205	16	No compatible	No compatible	20	20
8352V	195	36	20	20	25	25
8352 M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

**Tabla 22. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 3,5 pulgadas: enfriado con aire**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	3 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
8380	270	40	No compatible	No compatible	No compatible
8368	270	38	No compatible	No compatible	No compatible
8368Q	270	38	No compatible	No compatible	No compatible
8362	265	32	No compatible	No compatible	No compatible
8360Y	250	36	No compatible	No compatible	No compatible
8358	250	32	No compatible	No compatible	No compatible
8358P	240	32	No compatible	No compatible	No compatible
6348	235	28	No compatible	No compatible	No compatible
6342	230	24	No compatible	No compatible	No compatible
8351N	225	36	No compatible	No compatible	No compatible
8352Y	205	32	No compatible	No compatible	No compatible

**Tabla 22. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 3,5 pulgadas: enfriado con aire (continuación)**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	3 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
6314U	205	32	No compatible	No compatible	No compatible
8352S	205	32	No compatible	No compatible	No compatible
6338	205	32	No compatible	No compatible	No compatible
6330	205	28	No compatible	No compatible	No compatible
6354	205	18	No compatible	No compatible	No compatible
6346	205	16	No compatible	No compatible	No compatible
8352V	195	36	No compatible	No compatible	No compatible
8352 M	185	32	No compatible	No compatible	No compatible
6338N	185	32	No compatible	No compatible	No compatible
5320	185	26	No compatible	No compatible	No compatible
6336Y	185	24	No compatible	No compatible	No compatible
6312U	185	24	No compatible	No compatible	No compatible
6326	185	16	No compatible	No compatible	No compatible
6330N	165	28	No compatible	No compatible	20
6338T	165	24	No compatible	No compatible	20
5318Y	165	24	No compatible	No compatible	20
5318S	165	24	No compatible	No compatible	20
6334	165	8	No compatible	No compatible	20
5318N	150	24	No compatible	No compatible	20
5320T	150	20	No compatible	No compatible	20
4316	150	20	No compatible	No compatible	20
5317	150	12	No compatible	No compatible	20
5315Y	140	8	No compatible	20	20*
4314	135	16	No compatible	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30
4309Y	105	8	25	30	30

**Tabla 23. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador único con configuración de unidad directa de 3,5 pulgadas: enfriado con aire**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	3 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
8380	270	40	No compatible	No compatible	No compatible
8368	270	38	No compatible	No compatible	No compatible
8368Q	270	38	No compatible	No compatible	No compatible
8362	265	32	No compatible	No compatible	No compatible
8360Y	250	36	No compatible	No compatible	No compatible
8358	250	32	No compatible	No compatible	No compatible
8358P	240	32	No compatible	No compatible	20

**Tabla 23. Temperatura de funcionamiento máxima continua para procesador único con configuración de unidad directa de 3,5 pulgadas: enfriado con aire (continuación)**


Procesadores	TDP (W)	Núcleos	3 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
6348	235	28	No compatible	20	20
6342	230	24	No compatible	20	20
8351N	225	36	No compatible	No compatible	20
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	No compatible	20	25
6346	205	16	No compatible	20	25
8352V	195	36	20	25	25
8352 M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

**Tabla 24. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad NVMe de 2,5 pulgadas/directa de 2,5 pulgadas: enfriado por líquido**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35

**Tabla 24. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad NVMe de 2,5 pulgadas/directa de 2,5 pulgadas: enfriado por líquido (continuación)**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	6 unidades/sleds	4 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled	Sin BP
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352 M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

 **NOTA:** Se requieren restricciones térmicas adicionales para la configuración de GPU y LRDIMM de 128 GB, y PCIe > 25 W.

**Tabla 25. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 2,5 pulgadas: enfriado con líquido**

<b>Procesadores</b>	<b>TDP (W)</b>	<b>Núcleos</b>	<b>6 unidades/ sleds</b>	<b>4 unidades/ sleds</b>	<b>2 unidades/ sleds</b>	<b>1 unidad/sled</b>
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352 M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

**i** **NOTA:** Se requieren restricciones térmicas adicionales para la configuración de GPU y LRDIMM de 128 GB, y PCIE > 25 W.

**Tabla 26. Temperatura de funcionamiento máxima continua para doble procesador con configuración de unidad directa de 3,5 pulgadas: enfriado por líquido**

Procesadores	TDP (W)	Núcleos	3 unidades/sleds	2 unidades/sleds	1 unidad/sled
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8362	265	32	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35
8352 M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

**NOTA:** Se requieren restricciones térmicas adicionales para la configuración de GPU y LRDIMM de 128 GB, y PCIE > 25 W.

## Restricción de configuración de ASHRAE A3

**Tabla 27. Restricción de configuración de ASHRAE A3**

Enfriado por líquido	Enfriado por aire
<ul style="list-style-type: none"><li>● La SSD NVMe no es compatible.</li><li>● No se admite LRDIMM.</li><li>● Las tarjetas PCIe de más de 25 W no son compatibles.</li><li>● No se admite una tarjeta GPU.</li><li>● La configuración de unidad de 3,5 pulgadas no es compatible</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● La SSD NVMe no es compatible.</li><li>● No se admite LRDIMM.</li><li>● Las tarjetas PCIe de más de 25 W no son compatibles.</li><li>● No se admite una tarjeta GPU.</li><li>● La configuración de unidad de 3,5 pulgadas no es compatible</li><li>● Para el sled 1P, el máximo admitido de CPU TDP es 150 W.</li><li>● Para el sled 2P, el máximo admitido de CPU TDP es 105 W.</li></ul>